

芯联集成电路制造股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（草案）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

芯联集成电路制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行股份及支付现金购买绍兴滨海新区芯兴股权投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等 15 名交易对方合计持有的芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司 72.33%股权（以下简称“本次交易”）。

2025 年 1 月 10 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的审核问询函》（上证科审（并购重组）〔2025〕1 号），并于 2025 年 3 月 15 日披露了《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等文件，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关文件。

相较公司于 2024 年 12 月 30 日披露的《芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》，草案（修订稿）对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

章节	修订情况
目录	根据内容更新情况更新目录
释义	更新交易对方名称、曾用名等释义内容
重大事项提示	1、补充披露标的公司实现盈利增长的核心逻辑； 2、更新本次重组对上市公司股权结构的影响

章节	修订情况
第一章 本次交易概况	1、补充披露本次收购少数股权的必要性、合理性； 2、补充披露本次收购符合《中国证监会关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》关于收购优质未盈利资产的相关要求； 3、补充披露标的公司实现盈利增长的核心逻辑； 4、补充披露本次收购后上市公司与标的公司进一步挖掘协同效应、实现整合管控的具体路径； 5、更新本次重组对上市公司股权结构的影响
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司注册资本、历史沿革情况
第三章 交易对方基本情况	1、更新部分交易对方的工商信息、执行事务合伙人信息、对外投资、上层股权结构、出资人情况等内容； 2、更新部分交易对方存续期与锁定期匹配情况
第九章 管理层讨论与分析	1、更新硅基 MOSFET 和 IGBT 的市场规模数据及相关表述； 2、新增公司行业地位的表述； 3、补充披露报告期内标的公司其他收益的金额及主要内容

除上述补充和修订之外，公司对草案（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 3 月 15 日